(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2011 年 6 月 23 日(23.06.2011)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2011/074521 A1

(51) 国際特許分類:
H01L 21/027 (2006.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2010/072342

(22) 国際出願日: 2010 年 12 月 13 日(13.12.2010)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願 2009-287797 2009 年 12 月 18 日(18.12.2009) JP
特願 2010-259231 2010 年 11 月 19 日(19.11.2010) JP

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 株式会社ジェイ・イー・ティ(J.E.T. CO., LTD.) [JP/JP]; 〒7190302 岡山県浅口郡里庄町大字新庄字金山６０７８番 Okayama (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 舟橋 倫正(FUNABASHI Michimasa) [JP/JP]; 〒1900012 東京都立川市曙町２丁目９－８ 大黒屋ビルジング 株式会社ジェイ・イー・ティ東京事務所内 Tokyo (JP). 乙訓 賢二(OTOKUNI Kenji) [JP/JP]; 〒1900012 東京都立川市曙町２丁目９－８ 大黒屋ビルジング 株式会社ジェイ・イー・ティ東京事務所内 Tokyo (JP). 江戸 裕樹(EDO Hiroki) [JP/JP]; 〒1900012 東京都立川市曙町２丁目９－８ 大黒屋ビルジング 株式会社ジェイ・イー・ティ東京事務所内 Tokyo (JP). 鈴木 秀明(SUZUKI Hideaki) [JP/JP]; 〒1900012 東京都立川市曙町２丁目９－８ 大黒屋ビルジング 株式会社ジェイ・イー・ティ東京事務所内 Tokyo (JP).

(74) 代理人: 嶋 宣之(SHIMA Nobuyuki); 〒1500002 東京都渋谷区渋谷１－８－６ 宮益坂ＳＴビル３０２ Tokyo (JP).

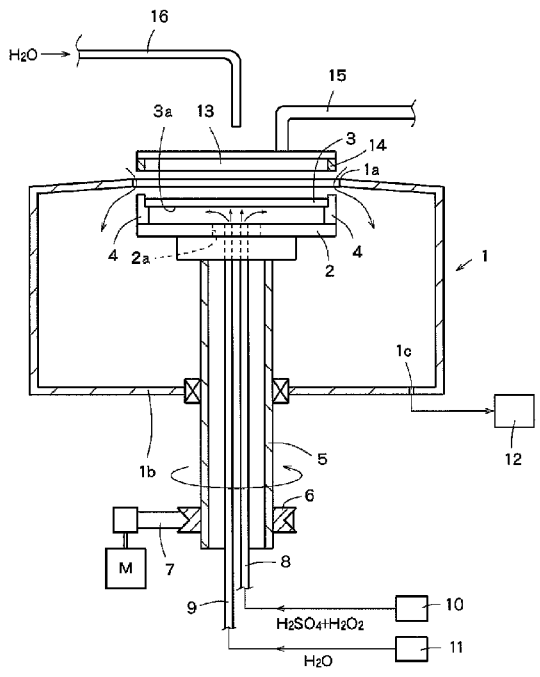
(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

[続葉有]

(54) **Title**: SUBSTRATE TREATMENT DEVICE

(54) 発明の名称 : 基板処理装置

[図1]



(57) **Abstract**: Provided is a single substrate treatment-type substrate treatment device wherein not only treatment liquid or vapor from the treatment liquid is prevented from scatterring outward when a substrate is treated by directly supplying the treatment liquid onto the surface of the substrate but also the treatment liquid of the vapor is prevented from being attached to the ceiling surface, etc., of a housing. The substrate treatment device is provided with a housing (1); a retaining means (4) for retaining a substrate (3) in which foreign substances attached to the treatment surface are removed within the housing (1), so that the treatment surface (3a) of the substrate faces toward the bottom portion (1b) of the housing; a supply means for supplying treatment liquid to the treatment surface (3a) of the substrate (3) retained by the retaining means (4); a suction port (1a) for introducing gas into the housing (1); and a discharge port (1c) for discharging the vapor of treatment liquid within the housing (1) together with the gas introduced from the suction port (1a).

(57) 要約:

[続葉有]

WO 2011/074521 A1